

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2017-052

天通控股股份有限公司

关于对全资子公司进行增资的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：天通吉成机器技术有限公司（本公司的全资子公司，以下简称“天通吉成”）

●投资形式和金额：以自有资金向天通吉成增资人民币 1 亿元

一、本次增资的基本情况

1、为了增加天通吉成半导体设备研发投入及对未来提供更大的发展空间，公司决定以自有资金对天通吉成增资人民币 1 亿元。本次增资后，天通吉成的注册资本由 18,499.6841 万元人民币变更为 28,499.6841 万元人民币。

2、本次增资权限在公司董事会对董事长的授权范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、标的公司的基本情况

1、公司名称：天通吉成机器技术有限公司

2、注册地址：海宁市海宁经济开发区双联路 129 号

3、法定代表人：俞敏人

4、注册资本：18499.6841 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、成立时间：2002 年 9 月 30 日

7、经营范围：机电设备软件开发与应用、技术咨询服务；光通讯电子专用设备、微电子专用设备、圆盘干燥机、其他环保设备、数控机床、工业自动化设

备、模具的制造、加工；精密机械加工；普通货运；节能环保技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；尾气处理系统、污水处理系统、污泥处理系统的工程设计、安装、施工；机电设备安装服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

8、最近一年及一期的财务状况：

单位：万元

项目	2016年12月31日 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计	2017年9月30日 （未经审计）
资产总额	75,885.07	87,726.37
负债总额	35,272.48	42,139.72
净资产	40,612.59	45,586.65
营业收入	62,222.61	43,375.89
净利润	7,683.18	4,974.06

三、本次增资对公司的影响

本次增资主要用于天通吉成半导体晶体生长、研磨抛光、CMP 设备和 AMOLED 模组设备的研发投入，符合公司发展规划和业务发展的需要，有利于公司半导体材料与装备的国产化战略布局，以进一步提高公司的竞争力。

四、本次增资的风险分析

天通吉成为公司的全资子公司，本次增资对公司的合并报表不产生任何影响。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一七年十一月四日